

北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于 2021 年度公司及子公司申请金融机构授信额度
及担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”或“公司”）于 2021 年 4 月 14 日召开第三届董事会第四十二次会议及第三届监事会第二十八次会议，审议通过《关于 2021 年度公司及子公司申请金融机构授信额度及担保的议案》，具体情况如下：

为满足生产经营需要，公司预计 2021 年度向银行等金融机构申请不超过 50,000 万元人民币的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），具体银行授信单位以公司与相关银行实际签署为准，在上述额度范围内，公司及合并报表范围内子公司根据实际需求进行银行融资时可共同滚动使用。

如需公司及合并报表范围内子公司为上述授信提供连带责任保证担保，或以公司及合并报表范围内子公司名下相应的应收账款为该授信提供担保时，具体额度、使用要求、期限和费率、担保要求等以公司与银行最终签订的合同为准。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 16 日